

2011-2015年中国芯片设计 行业市场供需与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2015年中国芯片设计行业市场供需与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qtIT1107/C347750SSV.html>

【报告价格】纸介版7800元 电子版8300元 纸介+电子8800元

【出版日期】2011-07-06

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国芯片设计行业市场供需与投资前景研究报告》共十六章。首先介绍了芯片设计行业相关概述、中国芯片设计产业运行环境等，接着分析了中国芯片设计行业的现状，然后介绍了中国芯片设计行业竞争格局。随后，报告对中国芯片设计行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国芯片设计产业发展前景与投资预测。您若想对芯片设计产业有个系统的了解或者想投资芯片设计行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

随着电子技术的飞速发展，功耗问题正日益成为VLSI系统实现的一个限制因素，低功耗设计中的低电压设计、低电流设计以及相应的软硬件设计，已成为各公司竞相研究的重要领域。绿色设计几乎成为产品竞争力的代名词。在未来的22nm时代，金属线宽越来越小，要求离子束的点面积也要足够小，这将会是检测分析技术的挑战。设计更具能源效益的系统已是刻不容缓，电子技术使我们能拥有随时连网以及管理日益繁杂生活的能力，但每种用于连结的设备耗电量越来越大，绿色芯片设计势在必行。电子产品对功能需求的不断增长，导致市场需要更复杂和高度集成的硅产品。克服设计挑战、优化开发预算、缩短产品上市时间是满足电子产品应用需求的关键。对于众多的Foundry来说，芯片的设计直接决定了工艺的复杂程度和最终的产品性能，设计如何与制造工艺相结合是Foundry面临的问题之一。Foundry在设计方面面临的主要挑战有：便携式产品的应用，如电池寿命的延长、计算速度的飞速增长；高性能应用，如功率受限以及器件冷却等。目前全球已经有超过10亿台电脑投入使用，低功耗设计是芯片技术的发展方向。在IC制造领域，业内人士一直不断尝试着新材料和新工艺。对于功耗降低来说，它们的应用也是大有裨益，例如采用SOI技术可以使功耗降低20%左右，而金属栅和高k材料的研究也为低功耗的进步带来了不少契机。

目录

CONTENTS

第一部分 行业发展现状

第一章 芯片设计行业发展概述

第一节 芯片设计行业概述

一、芯片设计的定义

二、芯片设计的特性

第二节 行业界定

一、行业经济特性

二、细分市场概述

第三节 芯片设计行业发展成熟度分析

一、芯片设计行业发展周期分析

二、中外芯片设计市场成熟度对比

三、细分行业成熟度分析

第二章 国外芯片设计行业发展分析

第一节 全球芯片设计行业发展现状

一、2010-2011年全球芯片设计行业产业规模

二、2010-2011年全球芯片设计行业产业结构

第二节 全球芯片设计行业基本特点

一、市场繁荣带动产业加速发展

二、企业重组呈现强强联合趋势

第三节 主要国家和地区发展分析

一、2010-2011年美国芯片设计行业发展分析

二、2010-2011年日本芯片设计行业发展分析

三、2010-2011年台湾芯片设计行业发展分析

四、2010-2011年印度芯片设计行业发展分析

第四节 世界芯片设计行业发展现状分析

一、2010-2011年世界芯片设计行业发展规模分析

二、2010-2011年世界芯片设计行业发展特点分析

三、2010-2011年世界芯片设计行业竞争格局分析

第五节 2011年世界芯片设计行业发展形势分析

第六节 2011-2015年世界芯片技术发展趋势分析

一、小型化、高灵敏度

二、多功能趋势

三、芯片节能趋势

第三章 我国芯片设计行业发展现状

第一节 中国芯片设计行业现状

- 一、行业规模不断扩大
- 二、行业质量稳步提高
- 三、产品结构极大丰富
- 四、原材料与生产设备配套问题

第二节 芯片设计行业发展特点

- 一、产业持续快速发展
- 二、中国自主标准为国内设计企业带来发展机遇
- 三、模拟IC和电源管理芯片成为国内IC设计热门产品

第三节 2010-2011年芯片设计行业发展分析

- 一、2010-2011年芯片设计行业经济指标分析
- 二、2010-2011年芯片设计业进出口贸易分析
- 三、2010-2011年行业盈利能力与成长性分析
- 四、2010-2011年芯片设计行业发展规模分析
- 五、2010-2011年芯片设计行业发展特点分析

第四节 中国芯片设计业存在的主要问题分析

- 一、企业规模问题分析
- 二、产业链问题分析
- 三、资金问题分析
- 四、人才问题分析
- 五、发展的建议与措施

第四章 中国芯片设计市场运行分析

第一节 2010年中国芯片设计市场发展分析

- 一、2010年中国芯片设计市场消费规模分析
- 二、2010年主要行业对芯片的需求统计分析
- 三、2011年中国芯片设计市场消费规模分析
- 四、2011年主要行业对芯片的需求分析预测

第二节 2010年中国芯片制造市场生产状况分析

- 一、2010年芯片的产量分析
- 二、2010年芯片的产能分析

三、2010年产品生产结构分析

四、2011年芯片的产量分析

五、2011年芯片的产能分析

第五章 芯片设计产品细分市场分析

第一节 2011年中国芯片细分市场发展局势分析

一、生物芯片

二、通信芯片

三、显示芯片

四、数字电视芯片

五、标签芯片

第二节 电子芯片市场

一、电子芯片市场结构

二、电子芯片市场特点

三、2011年电子芯片市场规模

四、2010年电子芯片市场分析

五、2011-2015年电子芯片市场预测

第三节 通讯芯片市场

一、通讯芯片市场结构

二、通讯芯片市场特点

三、2011年通讯芯片市场规模

四、2010年通讯芯片市场分析

五、2011-2015年通讯芯片市场预测

第四节 汽车芯片市场

一、汽车芯片市场结构

二、汽车芯片市场特点

三、2011年汽车芯片市场规模

四、2010年汽车芯片市场分析

五、2011-2015年汽车芯片市场预测

第五节 手机芯片市场

一、手机芯片市场结构

二、手机芯片市场特点

三、2011年手机芯片市场规模

四、2010年手机芯片市场分析

五、2011-2015年手机芯片市场预测

第六节 电视芯片市场

一、电视芯片市场结构

二、电视芯片市场特点

三、2011年电视芯片市场规模

四、2010年电视芯片市场分析

五、2011-2015年电视芯片市场预测

第二部分 行业竞争格局

第六章 芯片设计产业发展地区比较

第一节 长三角地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第二节 珠三角地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第三节 环渤海地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第四节 东北地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第五节 西部地区

一、竞争优势

二、2010-2011年发展状况

三、2011-2015年发展前景

第七章 芯片设计行业竞争格局分析

第一节 中国芯片设计行业结构分析

一、行业的省份分布概况

二、行业销售集中度分析

三、行业利润集中度分析

四、行业规模集中度分析

第二节 芯片设计业竞争格局分析

一、国际芯片设计行业的竞争状况

二、我国芯片设计业的国际竞争力

三、外资企业进入国内市场的影响

四、IC设计企业面临的挑战分析

第三节 我国芯片设计业的竞争现状

一、我国芯片设计企业间竞争状况

二、潜在进入者的竞争威胁

三、供应商与客户议价能力

第四节 2010-2011年芯片设计行业竞争格局分析

一、2010年国内外芯片设计竞争分析

二、2010年我国芯片设计市场竞争分析

三、2010年我国芯片设计市场集中度分析

四、2011年国内主要芯片设计企业动向

第八章 芯片设计企业竞争策略分析

第一节 芯片设计市场竞争策略分析

一、2011年芯片设计市场增长潜力分析

二、2011年芯片设计主要潜力品种分析

三、现有芯片设计产品竞争策略分析

四、潜力芯片设计品种竞争策略选择

五、典型企业产品竞争策略分析

第二节 芯片设计企业竞争策略分析

一、金融危机对芯片设计行业竞争格局的影响

二、金融危机后芯片设计行业竞争格局的变化

三、2011-2015年我国芯片设计市场竞争趋势

- 四、2011-2015年芯片设计行业竞争格局展望
- 五、2011-2015年芯片设计行业竞争策略分析
- 六、2011-2015年芯片设计企业竞争策略分析

第九章 世界典型芯片设计企业竞争分析

第一节 高通 (QUALCOMM)

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2010-2011年经营状况
- 四、2011-2015年发展战略

第二节 博通 (BROADCOM)

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2010-2011年经营状况
- 四、2011-2015年发展战略

第三节 NVIDIA

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2010-2011年经营状况
- 四、2011-2015年发展战略

第四节 新帝 (SANDISK)

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2010-2011年经营状况
- 四、2011-2015年发展战略

第五节 AMD

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2010-2011年经营状况
- 四、2011-2015年发展战略

第十章 芯片设计优势企业竞争分析

第一节 上海华虹

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第二节 中星微电子

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第三节 中芯国际

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第四节 大唐微电子

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2010-2011年经营状况

四、2011-2015年发展战略

第五节 其他优势企业

一、士兰微电子

二、有研硅谷

三、上海蓝光

四、扬州华夏

五、深圳方大

六、大连路美

七、台湾信越

八、台湾威盛电子

第三部分 行业前景预测

第十一章 芯片设计行业发展趋势分析

第一节 2011年发展环境展望

一、2011年宏观经济形势展望

二、2011年政策走势及其影响

三、2011年国际行业走势展望

第二节 2011年相关行业发展展望

一、2011年IC制造业展望

二、2011年IC封装测试业展望

三、2011年IC材料和设备行业展望

第三节 芯片设计行业发展趋势分析

一、技术发展趋势分析

二、产品发展趋势分析

三、行业竞争格局展望

第四节 2011-2015年中国芯片设计市场趋势分析

一、2010-2011年芯片设计市场趋势总结

二、2011-2015年芯片设计发展趋势分析

三、2011-2015年芯片设计市场发展空间

四、2011-2015年芯片设计产业政策趋向

五、2011-2015年芯片设计技术革新趋势

六、2011-2015年芯片设计价格走势分析

七、2011-2015年国际环境对行业的影响

第十二章 未来芯片设计行业发展预测

第一节 2011-2015年国际芯片设计市场预测

一、2011-2015年全球芯片设计行业产值预测

二、2011-2015年全球芯片设计市场需求前景

三、2011-2015年全球芯片设计市场价格预测

第二节 2011-2015年国内芯片设计市场预测

一、2011-2015年国内芯片设计行业产值预测

二、2011-2015年国内芯片设计市场需求前景

三、2011-2015年国内芯片设计市场价格预测

四、2011-2015年国内芯片设计行业集中度预测

第四部分 投资战略研究

第十三章 芯片设计行业投资现状分析

第一节 2010年芯片设计行业投资情况分析

- 一、2010年总体投资及结构
- 二、2010年投资规模情况
- 三、2010年投资增速情况
- 四、2010年分行业投资分析
- 五、2010年分地区投资分析
- 六、2010年外商投资情况

第二节 2011年1季度芯片设计行业投资情况分析

- 一、2011年1季度总体投资及结构
- 二、2011年1季度投资规模情况
- 三、2011年1季度投资增速情况
- 四、2011年1季度分行业投资分析
- 五、2011年1季度分地区投资分析
- 六、2011年1季度外商投资情况

第十四章 芯片设计行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

- 一、2010-2011年我国宏观经济运行情况
- 二、2011-2015年我国宏观经济形势分析
- 三、2011-2015年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

- 一、2011年芯片设计行业政策环境
- 二、2011年国内宏观政策对其影响
- 三、2011年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

- 一、国内社会环境发展现状
- 二、2011年社会环境发展分析
- 三、2011-2015年社会环境对行业的影响分析

第四节 电子信息产业振兴规划

- 一、电子信息产业振兴规划概述

- 二、电子信息产业振兴规划细则
- 三、电子信息产业振兴规划三大任务
- 四、电子信息产业振兴规划六大工程
- 五、电子信息产业振兴规划十项措施
- 六、电子信息产业振兴规划的意义与作用
- 七、电子信息产业振兴规划对芯片设计行业的影响

第十五章 芯片设计行业投资机会与风险

第一节 2011-2015年行业投资机会分析

- 一、台湾放行四家芯片商投资大陆
- 二、半导体芯片产业或成投资热点
- 三、应用芯片研究前景广阔
- 四、生物芯片投资时刻到来

第二节 芯片设计行业投资效益分析

- 一、2010-2011年芯片设计行业投资状况分析
- 二、2011-2015年芯片设计行业投资效益分析
- 三、2011-2015年芯片设计行业投资趋势预测
- 四、2011-2015年芯片设计行业的投资方向
- 五、2011-2015年芯片设计行业投资的建议
- 六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响芯片设计行业发展的主要因素

- 一、2011-2015年影响芯片设计行业运行的有利因素分析
- 二、2011-2015年影响芯片设计行业运行的稳定因素分析
- 三、2011-2015年影响芯片设计行业运行的不利因素分析
- 四、2011-2015年我国芯片设计行业发展面临的挑战分析
- 五、2011-2015年我国芯片设计行业发展面临的机遇分析

第四节 芯片设计行业投资风险及控制策略分析

- 一、2011-2015年芯片设计行业市场风险及控制策略
- 二、2011-2015年芯片设计行业政策风险及控制策略
- 三、2011-2015年芯片设计行业经营风险及控制策略
- 四、2011-2015年芯片设计行业技术风险及控制策略
- 五、2011-2015年芯片设计同业竞争风险及控制策略

六、2011-2015年芯片设计行业其他风险及控制策略

第十六章 芯片设计行业投资战略研究

第一节 芯片设计行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对我国芯片设计品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、芯片设计实施品牌战略的意义

三、芯片设计企业品牌的现状分析

四、我国芯片设计企业的品牌战略

五、芯片设计品牌战略管理的策略

第三节 芯片设计产业发展策略

一、芯片设计后续项目谈判策略

二、芯片设计企业发展策略分析

三、我国芯片设计产业提高全球交付能力策略

四、中国芯片设计业发展策略

第四节 芯片设计行业投资战略研究

一、2011年电子产业行业投资战略

二、2011年芯片设计行业投资战略

三、2011-2015年芯片设计行业投资战略

四、2011-2015年细分行业投资战略

图表目录

图表：芯片设计产业的价值链

图表：芯片设计产业与其他产业的关系

图表：芯片设计行业链结构图

图表：2003-2010年中国集成电路产业销售收入规模及增长

图表：2010年中国集成电路产业各产业链销售收入及增长

图表：2010年中国集成电路产业各价值链结构

图表：全球IC设计产业产值发展趋势

图表：IC设计产业成长优于全球IC产业成长

图表：2009年全球半导体电子设备设计国家排名

图表：全球IC设计产业布局

图表：全球IC设计产业概况

图表：2009年台湾地区前十大设计公司

图表：台湾地区历年前十大设计公司营收变化趋势

图表：2002-2010年台湾主要无晶圆厂IC设计公司营收走势

图表：2004-2010年台湾主要电源IC设计公司营收走势

图表：2001-2010年间国内生产总值增长趋势

图表：2005Q1-2010Q4年各季度国内生产总值走势

图表：2003-2010年工业增加值及增长速度

图表：2010年主要工业产品产量及其增长速度

图表：2010年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度

图表：2003-2010年固定资产投资增长情况

图表：2001-2010年中国投资率和消费率变化情况

图表：我国有线电视向数字化过渡时间表

图表：低功率芯片技术实现

图表：微笑曲线

图表：2009年中国前十大IC设计业者排名

图表：2002-2010年IC设计业销售收入

图表：2005-2010年我国芯片设计业经济指标

图表：我国IC设计业的SWOT分析

图表：西部地区一些IC设计公司

图表：2010年中国电源管理芯片市场品牌结构

图表：DLP工作原理

图表：使用DLP技术的厂商一览

图表：LCOS面板结构图

图表：2010年我国主要宏观经济指标增长的市场预测

图表：中国集成电路产业规模和增长速度

图表：2010-2015年中国集成电路产业规模预测

图表：2010-2015年中国集成电路产业链规模与增长预测

图表：2010-2011年我国IC销售额预测

图表：中国IC市场应用结构及自给能力

图表：2006-2010年华虹集团经营动态

图表：中芯国际技术文件的支持

图表：2010年全球10大半导体供应商的初步排名

图表：iSuppli按公司总部所在地对全球半导体销售额进行的初步估计

图表：软硬件协同设计流程

图表：软硬件协同设计流程

图表：设计人员正在使用电压岛、电源门控和其他功率控制技巧

图表：1999~2006年我国集成电路芯片产量变动轨迹

图表：1999~2006年集成电路及芯片产量变动轨迹

图表：2009年中国市场NVIDIA与ATI新品关注比例对比

图表：2010年中国市场最受关注的前十大显示芯片

图表：2005年中国手机基带芯片市场份额分布

图表：2010年大唐微电子技术公司主营构成

图表：2010年大唐微电子技术公司每股收益指标

图表：2010年大唐微电子技术公司获利能力指标

图表：2010年大唐微电子技术公司经营能力指标

图表：2010年大唐微电子技术公司偿债能力指标

图表：2010年大唐微电子技术公司资本构成指标

图表：2010年大唐微电子技术公司发展能力指标

图表：2010年大唐微电子技术公司现金流量指标

图表：2010年中芯国际综合损益表

图表：2010年中芯国际资产负债表

图表：2010年中芯国际现金流量表

图表：:2010年中芯国际业务构成

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司主营构成

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司每股收益指标

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司盈利能力指标

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司经营能力指标

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司偿债能力指标

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司资本结构指标

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司发展能力指标

图表：2010年杭州士兰微电子股份有限公司现金流量指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司主营构成

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司每股收益指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司获利能力指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司经营能力指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司偿债能力指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司资本结构指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司发展能力指标

图表：2010年南通富士通微电子股份有限公司现金流量指标

图表：2003-2010年电信综合价格水平

图表：2003-2010年电话用户到达数和新增数

图表：2003-2010年移动电话用户所占比重

图表：2005-2010年移动电话用户各月净增比较

图表：2004年以来各月移动分组数据用户发展情况

图表：2005-2010年固定电话用户各月净增比较

图表：2003-2010年无线市话用户所占比重

图表：2003-2010年公用、办公、住宅电话用户所占比重

图表：2003-2010年网民数和互联网普及率

图表：2004年以来各月互联网拨号、宽带接入用户净增比较

图表：2003-2010年固定本地电话通话

图表：2003-2010年移动本地电话通话时长

图表：2010年长途电话通话时长

图表：2003-2010年长途电话市场构成

图表：2006-2010年IP电话发起方式

图表：2004-2010年短信业务发展情况

图表：2002-2010年我国汽车产量变化趋势图

图表：1994-2010年中国汽车行业销量

图表：2001-2010年汽车零部件行业利润变化

图表：2001-2010年整车行业库存水平变化

图表：2005-2011年汽车销量预测

图表：2001-2010年我国手机产量变化趋势图

图表：2010年手机品牌的市场份额

图表：2010年正货、水货和二手手机的市场份额

图表：2009-2010年的重点机型

图表：2010-2015年中国集成电路产业规模预测

图表：2010-2015年中国集成电路产业链规模与增长预测

图表：2010年中国芯片制造业前十大企业销售额

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、工业和信息化部、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、计算机行业协会、中国电子元件行业协会、中国半导体行业协会、国内外相关刊物的基础信息以及各产业研究单位等公布和提供的大量资料。本报告对我国芯片设计行业发展现状、发展趋势、竞争格局、投资前景等进行了分析，重点对芯片设计营销策略和营销渠道等方面进行了深入探讨，是芯片设计企业、研究单位、销售企业以及相关企业和单位、计划投资于芯片设计行业的企业等准确了解目前中国芯片设计市场发展动态，把握行业发展趋势，制定市场策略的必备的精品。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qtIT1107/C347750SSV.html>